

**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司**  
**关于向金融机构申请银团授信额度的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、银团授信额度情况概述**

为满足广州集成电路FCBGA封装基板项目（以下简称“本项目”）建设资金需求，公司及全资子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森半导体”）拟以银团贷款方式向金融机构申请项目贷款额度，具体如下：

**（一）银团基本情况**

牵头行：国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行深圳分行

参贷行：招商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行等，实际参贷行以最终正式签署的合同为准。

**（二）具体授信内容**

借款主体：公司、广州兴森半导体

用款主体：广州兴森半导体

授信方式：共同借款

授信总额度：不超过29.40亿元人民币，具体各行承贷额度以最终正式签署的合同为准。

借款利率：以最终正式签署的合同为准。

借款期限：预计为 10 年（宽限期预计为 2 年，以最终正式签署的合同为准）。

担保方式：公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司拟为本项目贷款提供 29.40 亿元的全额连带责任保证担保；此外，广州兴森半导体拟以本项目的土地使用权及机器设备提供抵押担保；项目建成后，广州兴森半导体将增加地上建筑物为本项目贷款提供抵押担保（具体担保以最终正式签署的合同为准）。

综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司及广州兴森半导体与相关机构实际发生的融资金额为准，融资期限、利率、信用结构等具体贷款条件以最终正式签署的合同为准。

授权公司董事长与相关机构签署前述综合授信额度项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同等本项目所须的各类法律性文件及后续不时之变更、补充）。

## 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日